



(11) **EP 1 569 865 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
B81C 1/00 (2006.01) **B81C 3/00** (2006.01)
B81B 3/00 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
18.06.2008 Patentblatt 2008/25

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE2003/004015

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
13.02.2008 Patentblatt 2008/07

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2004/050546 (17.06.2004 Gazette 2004/25)

(21) Anmeldenummer: **03782134.5**

(22) Anmeldetag: **05.12.2003**

(54) **Herstellen von mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) über ein Silizium-Hochtemperatur-Fusionsbonden von Scheiben**

Production of microelectromechanical systems (MEMS) using the high-temperature silicon fusion bonding of wafers

Fabrication de microsystèmes électromécaniques(MEMS) par liaison de plaquettes par fusion haute température du silicium

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

(56) Entgegenhaltungen:
WO-A-00/36385 **US-A- 4 463 336**
US-A- 6 012 336

(30) Priorität: **05.12.2002 DE 10257097**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.09.2005 Patentblatt 2005/36

(73) Patentinhaber: **X-FAB Semiconductor Foundries**
AG
99097 Erfurt (DE)

(72) Erfinder: **SCHWARZ, Uwe**
99102 Erfurt-Niedernissa (DE)

(74) Vertreter: **Fricke, Joachim**
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Postfach 10 09 62
80083 München (DE)

- **PARAMESWARAN L ET AL: "A merged MEMS-CMOS process using silicon wafer bonding" ELECTRON DEVICES MEETING, 1995., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 10-13 DEC. 1995, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, 10. Dezember 1995 (1995-12-10), Seiten 613-616, XP010161161 ISBN: 0-7803-2700-4**
- **PETERSEN K ET AL: "Fabrication of SOI wafers with buried cavities using silicon fusion bonding and electrochemical etchback" SENSORS AND ACTUATORS A, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, Bd. 54, Nr. 1-3, 1. Juni 1996 (1996-06-01), Seiten 709-713, XP004077953 ISSN: 0924-4247**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 1 569 865 B8